

2018-2023年中国半导体产业市场现状规划调查与 投资价值前景评估报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国半导体产业市场现状规划调查与投资价值前景评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/298262298262.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

未来物联网的应用领域包括智能家居、车联网、智慧城市、可穿戴设备等。当前物联网的终端设备中，半导体需求主要集中在传感器、嵌入式处理器、射频器件等三类。

嵌入式处理器是物联网的“大脑”，低功耗、高可靠性的处理器芯片是物联网几乎所有环节都必不可少的关键部件之一。提供“大脑”功能的系统芯片——嵌入式微处理器，一般是MCU/SoC形式。传感器是“眼睛”。传感器是一种检测装置，用于采集各类信息并转换为数字信号，可以采集温湿度、光线、声音、压力，或者身份特征、运动状态、地理位置等信息。从应用来看，传感器包括RFID、条形码、二维码、摄像头、雷达等。

射频器件是“耳朵”。射频器件是物联网接入网络和定位的关键设备。常见的局域网技术有Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等，以及2G/3G/4G等广域网技术。典型射频器件工艺较为复杂，基本被美国和日本公司所垄断。收发机、基带芯片和包络追踪器采用CMOS工艺，功率放大器以砷化镓工艺为主，滤波器使用了压电材料和MEMS工艺，而天线则采用FPC或LDS等工艺制造。目前全球射频器件基本被国外公司垄断。比如苹果和三星的近三款手机，PA基本由Skyworks, Avago和Qorvo三家垄断；滤波器供应商主要有Murata, Avago, Taiyo Yuden, TDK和Qorvo；收发机供应商主要是高通、三星和英特尔。

物联网强力拉动终端半导体市场 2014年新增物联网接入设备数量为14.1亿，终端半导体市场规模约为119亿美元；2015年新增物联网接入设备达到17亿，终端半导体市场成长29%达到154亿美元，而2016年成长将进一步接近184亿美元。物联网终端半导体正快速变成一个极具规模的市场，预计到2019年市场规模将超过296亿美元，2016-19年CAGR约为18%。

物联网半导体市场需求及市场容量

中国报告网发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格

数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章 2015-2017年中国半导体材料产业运行环境分析

第一节 2015-2017年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、城乡居民家庭人均可支配收入
- 三、恩格尔系数
- 四、中国城镇化率
- 五、存贷款利率变化
- 六、财政收支状况

第二节 2015-2017年中国半导体材料产业政策环境分析

- 一、《电子信息产业调整和振兴规划》
- 二、新政策对半导体材料业有积极作用
- 三、进出口政策分析

第三节 2015-2017年中国半导体材料产业社会环境分析

第二章 2015-2017年半导体材料发展基本概述

第一节 主要半导体材料概况

- 一、半导体材料简述
- 二、半导体材料的种类
- 三、半导体材料的制备

第二节 其他半导体材料的概况

- 一、非晶半导体材料概况
- 二、GaN材料的特性与应用
- 三、可印式氧化物半导体材料技术发展

第三章 2015-2017年世界半导体材料产业运行形势综述

第一节 2015-2017年全球总体市场发展分析

- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、亚太地区的半导体出货量受金融危机影响较小
- 五、模拟IC遭受重挫，无线下滑幅度最小

第二节 2015-2017年主要国家或地区半导体材料行业发展新动态分析

- 一、比利时半导体材料行业分析

二、德国半导体材料行业分析

三、日本半导体材料行业分析

四、韩国半导体材料行业分析

五、中国台湾半导体材料行业分析

第四章 2015-2017年中国半导体材料行业运行动态分析

第一节 2015-2017年中国半导体材料行业发展概述

一、全球代工将形成两强的新格局

二、应加强与中国本地制造商合作

三、电子材料业对半导体材料行业的影响

第二节 2015-2017年半导体材料行业企业动态

一、元器件企业增势强劲

二、应用材料企业进军封装

第三节 2015-2017年中国半导体材料发展存在问题分析

第五章 2015-2017年中国半导体材料行业技术分析

第一节 2015-2017年半导体材料行业技术现状分析

一、硅太阳能技术占主导

二、产业呼唤政策扩大内需

第二节 2015-2017年半导体材料行业技术动态分析

一、功率半导体技术动态

二、闪光驱动器技术动态

三、封装技术动态

四、太阳光电系统技术动态

第三节 2018-2023年半导体材料行业技术前景分析

第六章 2015-2017年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

第一节 2015-2017年中国第三代半导体材料相关介绍

一、第三代半导体材料的发展历程

二、当前半导体材料的研究热点和趋势

三、宽禁带半导体材料

第二节 2015-2017年中国氮化镓的发展概况

一、氮化镓半导体材料市场的发展状况

二、氮化镓照亮半导体照明产业

三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节 2015-2017年中国氮化镓的研发和应用状况

- 一、中科院研制成功氮化镓基激光器
- 二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
- 三、非极性氮化镓材料的研究有进展
- 四、氮化镓的应用范围

第七章 2015-2017年中国其他半导体材料运行局势分析

第一节 砷化镓

- 一、砷化镓单晶材料国际发展概况
- 二、砷化镓的特性
- 三、砷化镓研究状况
- 四、宽禁带氮化镓材料

第二节 碳化硅

- 一、半导体硅材料介绍
- 二、多晶硅
- 三、单晶硅和外延片
- 四、高温碳化硅

第八章 2015-2017年中国半导体分立器件制造业主要指标监测分析

第一节 年中国半导体分立器件制造行业数据监测回顾

- 一、竞争企业数量
- 二、亏损面情况
- 三、市场销售额增长
- 四、利润总额增长
- 五、投资资产增长性
- 六、行业从业人数调查分析

第二节 2015-2017年（按季度更新）中国半导体分立器件制造行业投资价值测算

- 一、销售利润率
- 二、销售毛利率
- 三、资产利润率
- 四、未来5年半导体分立器件制造盈利能力预测

第三节 2015-2017年（按季度更新）中国半导体分立器件制造行业产销率调查

- 一、工业总产值
- 二、工业销售产值
- 三、产销率调查

第九章 2015-2017年中国半导体市场运行态势分析

第一节 LED产业发展

- 一、国外LED产业发展情况分析
- 二、国内LED产业发展情况分析
- 三、LED产业所面临的问题分析
- 四、2018-2023年LED产业发展趋势及前景分析

第二节 集成电路

- 一、中国集成电路销售情况分析
- 二、集成电路及微电子组件进出口数据分析
- 三、集成电路产量统计分析

第三节 电子元器件

- 一、电子元器件的发展特点分析
- 二、电子元件产量分析
- 三、电子元器件的趋势分析

第四节 半导体分立器件

- 一、半导体分立器件市场发展特点分析
- 二、半导体分立器件产量分析
- 三、半导体分立器件发展趋势分析

第十章 2015-2017年中国半导体材料行业市场竞争态势分析

第一节 2015-2017年欧洲半导体材料行业竞争分析

第二节 2015-2017年我国半导体材料市场竞争分析

- 一、半导体照明应用市场突破分析
- 二、单芯片市场竞争分析
- 三、太阳能光伏市场竞争分析

第三节 2015-2017年我国半导体材料企业竞争分析

- 一、国内硅材料企业竞争分析
- 二、政企联动竞争分析

第十一章 中国半导体材料主要生产商竞争性财务数据分析

第一节 有研半导体材料股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第二节 天津中环半导体股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第三节 宁波康强电子股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第四节 南京华东电子信息科技股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第十二章 2018-2023年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节 2018-2023年中国半导体材料行业市场趋势

一、2018-2023年国产设备市场分析

二、市场低迷创新机遇分析

三、半导体材料产业整合

第二节 2018-2023年中国半导体行业市场发展预测分析

一、全球光通信市场发展预测分析

二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

第三节 2018-2023年中国半导体市场销售额预测分析

第四节 2018-2023年中国半导体产业预测分析

一、半导体电子设备产业发展预测分析

二、GPS芯片产量预测分析

三、高性能半导体模拟器件的发展预测

第十三章 2018-2023年中国半导体材料行业投资咨询分析

第一节 2018-2023年中国半导体材料行业投资环境分析

第二节 2018-2023年中国半导体材料行业投资机会分析

一、半导体材料投资潜力分析

二、半导体材料投资吸引力分析

第三节 2018-2023年中国半导体材料行业投资风险分析

一、市场竞争风险分析

二、政策风险分析

三、技术风险分析

第四节 专家建议

图表目录:

图表 1中国主要宏观经济数据增长表

图表 2 2015-2017年中国GDP及其增长率统计表

图表 3 2015-2017年中国GDP增长率季度统计表

图表 4 2015-2017年中国GDP增长率季度走势图

图表 5 2015-2017年中国居民收入及恩格尔系数统计表

图表 6 中国城乡居民收入走势对比

图表 7 2015-2017中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表 8 2015-2017中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表 9 2015-2017年中国城镇化率走势图

图表 10 2015-2017年央行历次存贷款基准利率

更多图表详见正文（GSLWK）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/298262298262.html>